

無限の可能性を持った
多様な先端表面処理
技術を世界へ

株式会社 オジック テクノロジーズ

熊本県
熊本市上熊本2-9-9

1947年(昭和22年)設立
TEL 096-352-4450

<http://www.ogic.ne.jp/>



代表取締役社長
金森 秀一

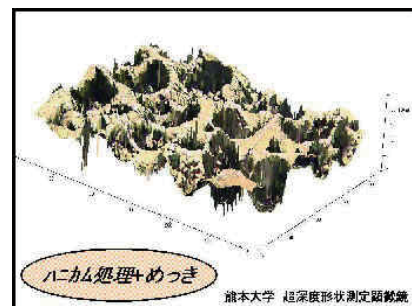
ユーザーが求める表面処理を研究・開発。複数の科学技術を持つ会社。
動力制御用特殊モジュールセラミックス基板への表面処理。

セラミックス基板への無電解ニッケルめっき処理技術

高電流のモジュール基板や絶縁放熱板などに使用される複合セラミックス基板（AlN、SiC/Al）へのめっき密着性を向上させる処理（無電解ニッケルめっき処理）を開発した。インバーターを搭載した高速エレベーターやエアコン、新幹線、熊本市電（低床路面電車）、自動車（ハイブリッドカー）などの省エネルギーシステムのキーパーツとして使用されている。

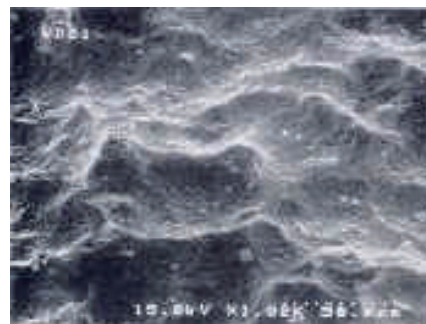
ハニカム処理技術

半導体実装用基板であるCu製の基板は樹脂の密着性向上が求められており、一般的にショットブラスト処理が用いられているが、ブラスト粒子残存、基板の反り、歪みが発生するため、特殊エッチング処理（ハニカム構造）を開発した。



オーデント処理技術 (独自の技術で、アルミニウム表面に緻密な尖形を形成)

液晶、有機EL、PDP、等の製造装置は、ガラス基板を据置・取外す時に静電気が発生し剥離帯電現象が起こる。
ガラス基板搭載台にオーデント処理することにより、ガラス基板に発生する静電気(接触帯電)を軽減する。



無電解ニッケルの複合めっき

無電解ニッケルなどにポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を複合材粒子として含有させる事で、摩擦係数が低減し摺動性の優れた表面を形成する。油を極端に嫌う部品でありながら、摺動運動を繰り返す部品などに最適である。

また、非粘着性、高硬度、非常電性、消音効果等の特徴もあり、真空装置部品やクリーンルーム内で使用する物への表面処理として活用されている。